Bienvenue sur O-MORT

O-Lead Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique de la chaîne d'approvisionnement EMS, y compris la conception de la PCB, la fabrication de circuits imprimé et l'assemblage de la PCB, nous fournissons une partie de la technologie PCB la plus avancée, y compris des PCB HDI, des PCB multicouches, des PCBS flexibles rigides. Nous pouvons Soutien du prototype de virage rapide à la production moyenne et en masse.

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: une réponse rapide, des prix compétitifs et un engagement de la qualité.LI PRODUIRE Un service technique plus précieux et une solution globale est la voie à suivre.

En ce qui concerne l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie de fabrication de l'électronique comme toujours et rendent les efforts persistants sur le service unique de PCB & PCBA afin de fournir des services de première classe et de créer plus de valeur pour nos clients.

Veuillez cliquer sur celles-ci pour plus d'informations: Low coût de fabrication de circuit imprimé POE Fabrication OEM



Description du produit

Raspberry Pi Poe Feature Compute Module Io Board (**Chine HFabricant de la carte de circuit** imprimé de module de trou d'Alf)

Aperçu

La carte Poe Module Compute est une carte de développement que vous pouvez brancher un module de calcul de Raspberry Pi dans et utilisez les ressources de PI de manière plus flexible. Avec la fonction POE (Power Over Ethernet) et les interfaces périphériques à bord polyvalentes, il convient également à l'évaluation du module de calcul de la Raspberry Pi, est également un choix idéal pour les produits finaux.

Fonctionnalités

- * En-tête de Raspberry Pi GPio, pour connecter des sortes de chapeaux PI de framboise
- * Port Ethernet de négociation automatique 10 / 100m, avec Poe activé
- * Les ports USB 4x permettent de connecter plus de périphériques USB.
- * 2x interfaces de caméra CSI
- * Interfaces HDMI / DSI intégrées pour les affichages de connexion
- * USB à UART à UART, pour le débogage en série
- * Interface de ventilateur de refroidissement, exécution automatique sur la mise sous tension ou contrôlée par des broches IO
- * Adopte des SMP isolées (alimentation en mode de commutation)

Caractéristiques

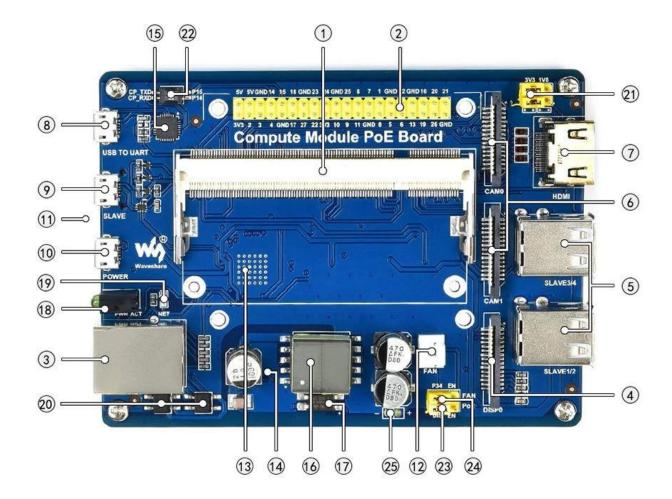
* Alimentation: Port Port USB / Poe Poe Port / Poe

* POE POWER INPUT: 37V ~ 57V DC dans * POWE POWER SORTIE: 5V 2.5A DC OUT

* Norme réseau: Standard POE 802.3AF

* Dimensions: 114mm × 84.4mm * Taille du trou de montage: 3.2mm

Ce qui est à bord



- 1. Interface de module de calcul: pour connecter le module de calcul (cm3 / cm3l / cm3 + / cm3 + l)
- 2. Raspberry Pi GPIO en-tête: pour connecter des chapeaux PI de framboise
- 3. Port Ethernet compatible Poe: négociation automatique 10 / 100m, pour connecter le routeur ou le commutateur avec la fonction PoE
- 4. Interface DSI: Ports d'affichage, pour la connexion de Raspberry Pi LCD
- 5. Ports USB: ports USB 4x, pour connecter des périphériques USB
- 6. Interface CSI: ports de caméra CSI 2x, pour connecter la caméra PI de framboise
- 7. Port HDMI
- 8. Interface USB à UART: pour le débogage en série
- 9. Interface esclave USB: vous permet de graver l'image système dans le module de calcul 3/3 +
- 10. PORTANT POWER: 5V 2.5A
- 11. Slot de carte TF (côté inférieur): Insérez une carte micro SD avec système pré-brûlé, pour démarrer le module de calcul de calcul 3/3 + lite variante
- 12. Interface de ventilateur de refroidissement
- 13. LAN9514 (côté inférieur): Hub USB entièrement intégré et contrôleur Ethernet 10 / 100m
- 14. puce de gestion de puissance SI3404 POE (côté inférieur)
- 15. CP2102 USB au convertisseur UART
- 16. Transformateur d'alimentation POE EP13
- 17. Isolateur optique
- 18. Deux indicateurs à LED:

Rouge: Indicateur de puissance PI de framboise

Green: Indicateur d'état de fonctionnement de la framboise PI

- 19. Indicateur réseau net
- 20. redresseur de pont
- 21. Jumper VGX Power Config: configurez le niveau d'E / S
- 22. Configuration de la sortie UART:

À gauche: Connectez le port série CP2102 et le port série Raspberry PI Droite: Débranchez le port série CP2102 et le port série Raspberry Pi

23. Fan de refroidissement Config:

P34: Le ventilateur est contrôlé par programme via P34 PIN

FR: Le ventilateur est directement alimenté à partir d'une alimentation 5V

24. POE CONFIG: Dis: Désactiver Poe EN: Activer POE

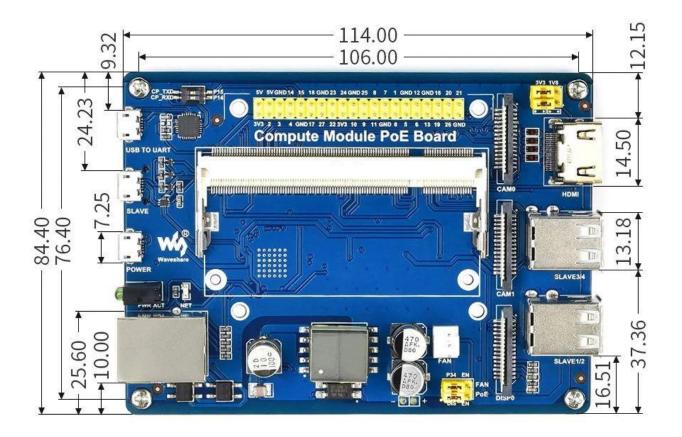
25. Pays de mesure de la tension d'alimentation POE

Exemple



Remarque: le module de calcul de la photo n'est pas inclus.

Dimensions



Notre équipe

To be #ELIABLE

Quality first ,

Customer supreme,

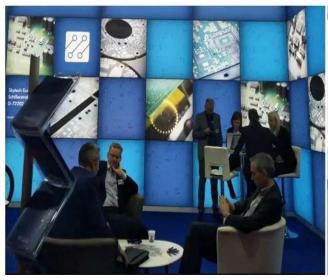
Scientifically management,

Striving for famous brand





THE CUSTOMER IS KING





To be VALUABLE

Science and technology keeps head ,

Put people first,

Be precise and practical,

contribute sincerely

Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT





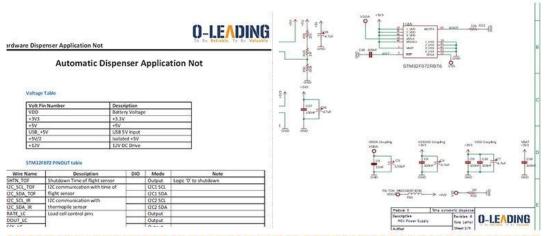








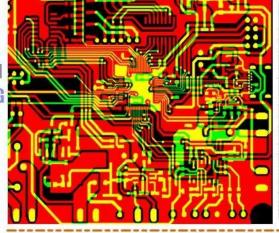
HOW O-LEADING MAKE A PROJECT FOR YOU



HARDWARE schematics

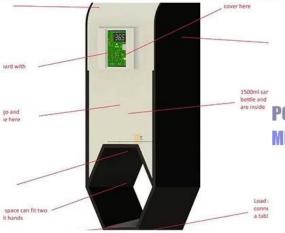
PCB PRODUCTION COMPONNETS SOURCING





Qty	Value	Device	Parts	Description
4	AK500/2	AK500/2	X1, X2,	CONNECTOR
1	AK500/3	AK500/3	X7	CONNECTOR
1	1241148	MA04-2	SV2	8,000 F. 100,11 S. 10 (10,000
1	PPPC04	MA04-2	SV1	8 POS , 4*2 FEMALE PIN HEADE
1	ML10	ML10	SV4	HARTING
1	8MHZ	XTALL_CSTCE8M	X5	STCE8M00G52-R0 RESONATOR
1	OR	R-0603	R53	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	10R	R-0603	R12, R5	Thick Film Resistors - SMD 0603
8	100R	R-0603	R1, R2,	Thick Film Resistors - SMD 0603
1	270R	R-0805	R15	Thick Film Resistors - SMD 0605
1	330R	R-0603	R11	Thick Film Resistors - SMD 0603
9	680R	R-0603	R20, R3	Thick Film Resistors - SMD 0603
17	1k	R-0603	R9, R10	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	4.7k	R-0603	R17, R6	Thick Film Resistors - SMD 0603
2	5.1k	R-0603	R18, R1	Thick Film Resistors - SMD 0603
9	10k	R-0603	R16, R3	Thick Film Resistors - SMD 0603
^	001	0.0000	200 05	TI . I FI D





PCB Assembly **MECHANICAL DESIGN**





































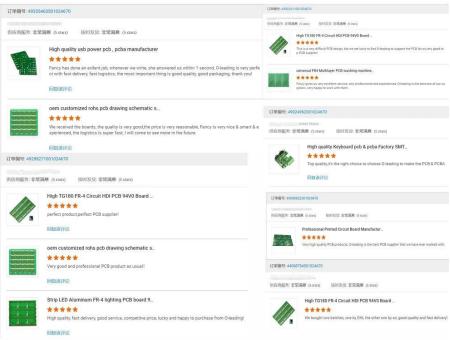


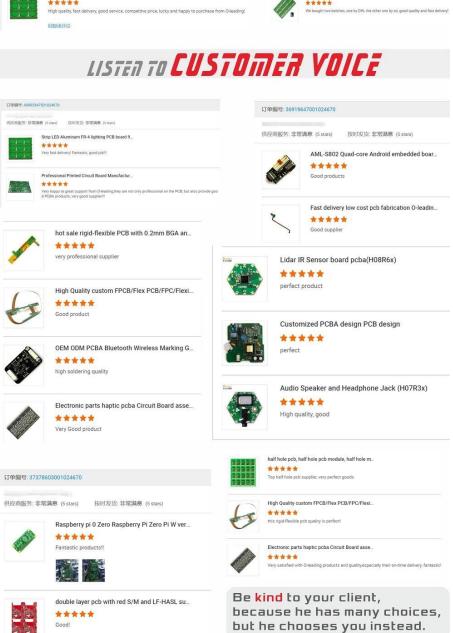




D-LEADING CUSTOMER REVIEW

customaa voica is **extraemely important** to us







Certifications

O-LEADING *TRANING*



There's a phrase in Buddhism, 'Beginner's mind.'

lt's wonderful to have a beginner's mind

WE HAVE A DREAM

Кеер *аппппБ*

I would like to live to study and not study to live.

----Bacon









Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG,

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : Date of Sample Received: 22 Mar 2019

RP19-005089 - SZ

22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Testing Period : Test Requested :

Selected test(s) as requested by client.

Test Method :

Please refer to next page(s).

Test Results :

Please refer to next page(s).

Conclusion:

Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyl set (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylnexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Disobutyl phthalate (DBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

lina

Tina Fan Approved Signatory



tillity is to its Client and this document does not exceed parties to under the transaction document. This document cannot be reproduce my. Any unauthorized alteration, forgery or faisification of the content of the prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the

SGS

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 2 of 6

Test Report Test Results :

Test Part Description :

SN1

SGS Sample ID SGS Sample ID Description SZX19-005304.001 Green"PCB"

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% (2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s) Limit Unit Cadmium (Cd) 100 ND mg/kg Lead (Pb) 1,000 Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 1.000 Sum of PBBs ND 1.000 mg/kg Monobromobiphenyl ND ND ND Dibromobiphenyl Tribromobiphenyl mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ND ND ND Tetrabromobiphenyl Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl mg/kg mg/kg mg/kg Heptabromobiphenyl ND ND ND ND Octabromobiphenyl Nonabromobiphenyl Decabromobiphenyl mg/kg mg/kg mg/kg ND ND ND Sum of PBDEs 1,000 Monobromodiphenyl ethe Dibromodiphen yl ether mg/kg Tribromodiphenyl ether mg/kg ND Tetrabromodiphenyl ether Pentabromodiphenyl ether



Max

Max

UL Product iQ™



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

Cond Width

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F TAI SANG BANK BLDG 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL, HONG KONG

		Min	Cond	SS/	Area	Solo	der	Oper		Meets	c
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Lim	its	Temp	Flame	UL796	T
Type	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	c	sec	c	Class	DSR	1
Multilayer (m	ass laminate) p	orinted wiring b	ooards.								
O-LEADING- 401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	100	:70
O-LEADING- 407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer pri	nted wiring bo	ards.		50							
O-LEADING- 408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer p	rinted wiring b	oards.							3 77	707	
O-LEADING- 002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING- 003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	A	128
O-LEADING- 033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING- 205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	120
O-LEADING- 206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	
O-LEADING- D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING- S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING- S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	НВ	A	*
O-LEADING- S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

 $[\]mbox{\ensuremath{\star}}$ - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品,才应该被视为经过UL认证,并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件: 1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证(文件)必须在不篡攻任何数据(或图纸)的情况下完整且无误导性地呈现。2."经 UL 允许从在线认证目录转载"声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外,转载材料必须包含以下格式的版权声明:"© 2019 UL LLC"

	Capa	acité du processus			
Capacités de production de PCB		<u> </u>			
Compte de couche	1Layer-32Lay	ver			
Épaisseur de cuivre finie	1 / 3oz-12oz				
Largeur de ligne min / espacement interne	3.0mil / 3.0mi	1			
Min ligne largeur / espacement externe	4.0mil / 4.0mi	1			
Ratio de format max	10: 1				
Épaisseur du tableau	0.2mm-5,0mr	1			
Taille du panneau max (pouces)	635 * 1500mi	m			
Taille de trou foré minimum	4mil				
Tolérance des trou portés	+/- 3mil				
Biind / Vias enterré (types AII)	OUI				
Via remplissage (conducteur, non conducteur)	OUI				
Matériel de base	FR-4, FR-4HI	GHT TG.HALOGEN MATERIAU GRATUIT, ROGERS, BASE D'ALUMINIUM,Polyimide, cuivre lourd			
Finitions de surface	HASL, OSPR,	ENIG, HAL-LF, LMMERSION Silver, Tin de Immersion, doigts d'or, encre de carbone			
Capacités de production SMT Matériel		FR-4, CEM-1, CEM-3, Boîte à base d'aluminium, FPC			
Taille maximale PCB		510x1500mm			
Taille Min PCB		50x50mm			
Épaisseur de la PCB		0.5mm-4.5mm			
Épaisseur du tableau		0.5-4mm			
Taille des composants min		0201			
Composant de taille de puce	standard	0603 et plus grand			
Composant max hauteur		15mm			
Min PLAD		0.3mm			
MIN BGA BALL		0.4mm			
Précision de placement		+/- 0.03mm			

Emballage et livraison

Shipping service











	Quick Turn Lead Time						
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement					
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours					
4L	3-4days	48 Hours					
6L	4-5days	72 Hours					
8L	5-6days	NA					
10L	6-7days	NA					
12L	7-8days	NA					
14L	8-9days	NA					

	Standard Lead Time						
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time					
2L	4 days	10 days					
4L	5 days	11 days					
6L	6 days	12 days					
8L	8 days	14 days					
10L	10 days	16 days					
12L	12 days	18 days					
14L	14 days	20 days					
16-32L	18 days	24 days					

FAQ

1. Comment O-dirigeant de la qualité de la qualité? Notre norme de haute qualité est obtenue avec ce qui suit.

- 1.1 Le processus est strictement contrôlé dans les normes ISO 9001: 2008.
- 1.2 Utilisation approfondie du logiciel dans la gestion du processus de production
- 1.3 Equipements et outils de test de pointe. Par exemple. Sonde volante, inspection des rayons X, AOI (inspecteur optique automatisé) et TIC (test en circuit).
- 1.4. Équipe d'assurance qualité sur la qualité avec processus d'analyse de cas d'échec
- 1.5. Entraînement et éducation du personnelContinu

2. Comment O-MORD maintient votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreux matières premières (par exemple le cuivre, les produits chimiques) ont doublé, triplés ou quadruplés; La monnaie chinoise RMB avait apprécié 31% sur le dollar américain; Et notre coût de la main-d'œuvre a également augmenté de manière significative. Cependant, O-leader a gardé nos prix stables. Cela est entièrement à nos innovations pour réduire les coûts, éviter les déchets et améliorer l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement bénéfique si nous pouvons vous fournir un coût et une qualité de Edgeon.

3. Quels types de conseils peuvent-ils suivre un processus de premier plan?

Les planches communes FR4, High-TG et sans halogènes, Rogers, Arlon, Telfon, planches à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production PCB & PCBA?

- 4.1 BOM (Projet de loi) avec designateurs de référence: Description du composant, Nom du fabricant et numéro de pièce.
- 4.2 Fichiers Gerber PCB Gerber.
- 4.3 Dessin de fabrication PCB et dessin de l'assemblage de PCBA.
- 4.4 Procédures de test.
- 4.5 Toutes les restrictions mécaniques telles que les exigences de hauteur de montage.

5. Quel est le flux de processus typique pour la PCB multicouche?

Coupe de matériaux \rightarrow Film sec \rightarrow Gravure intérieure \rightarrow Multi-Bond \rightarrow Multi-Bond \rightarrow Couche Empilage en appuyant sur \rightarrow Panneau \rightarrow PTH \rightarrow Panneau de panneau \rightarrow Film sec \rightarrow Placage de motif \rightarrow Gravure extérieure \rightarrow Masque externe \rightarrow Masque à souder \rightarrow Componente \rightarrow Finition de la surface \rightarrow Routage \rightarrow E / T \rightarrow Inspection visuelle.

6. Quels sont les équipements clés pour la fabrication du HDI?

La liste des équipements de clé est la suivante: la machine à forage au laser, la machine à appuyer sur la machine VCP, la machine d'exposition automatique, la LDI et etc.

Les équipements que nous avons sont les meilleurs dans l'industrie, les machines de forage au laser proviennent de Mitsubishi et de Hitachi, des machines LDI proviennent de l'écran (Japon), des machines à exposer automatiques sont également originaires de Hitachi, chacun permet de répondre aux exigences techniques du client.

7. Combien de types de finition de surface o-plomb peut faire?

O-Le leader a la série complète de la finition de surface, telle que: Enig, OSP, LF-HASL, Placage d'or (doux / dur), argent immersion, étain, placage d'argent, placage d'étain d'immersion, encre de carbone et etc. OSP, ENIG, OSP + ENIG couramment utilisé sur le HDI, nous vous recommandons généralement d'utiliser un client ou une éniggion OSP + OSP + si la taille du coussinet BGA est inférieure à 0,3 mm.

8. Quelle est votre capacité pour FPC? O-leader peut-il fournir un service SMT aussi?

O-leader peut fabriquer FPC de la couche unique à 8Layer, la taille du panneau de travail peut être aussi grande que 2000mm * 240mm, veuillez trouver les détails de la page "FLEX Capacité". Nous fournissons également un service SMT One Stop au client.

9. Quels sont les principaux facteurs qui affecteront le prix du PCB?

Matériel;

Finition de surface;

Difficulté technologique;

Critères de qualité différents;

Caractéristiques du PCB;

Modalités de paiement;

Différents pays de fabrication.

10. Quelle est la définition de PCB, PWB et FPC et quelle est la différence?

PCB est court pour la carte de circuit imprimé;

PWB est court pour la carte métallique imprimée, même sens que la carte de circuit imprimé; FPC est court pour une carte imprimée flexible.

11. Quels facteurs doivent être pris en compte lors du choix du matériel pour une carte PCB?

Les facteurs ci-dessous doivent être pris en compte lorsque nous choisissons le matériel de PCB:

La valeur TG du matériau doit être supérieure à la température de fonctionnement;

Faible matériau CTE a de bonnes performances de stabilité thermique;

Bonne performance de résistance thermique: Normalement, les PCB sont nécessaires pour résister à 250 pendant au moins 50 ans.

Bonne planéité; Compte tenu des propriétés électriques, une faible perte / un matériau de permittivité élevée est utilisée sur les PCB haute fréquence; Substrat de fibre de verre en polyimide utilisé pour PCB flexible; Le noyau métallique est utilisé lorsque le produit a une exigence stricte de dissipation de chaleur.

12. Quel est le mérite du PCB rigide-flexible de O-leader?

Le circuit imprimé rigide-Flex de O-Madard présente les caractères de FPC et de PCB, de sorte qu'il peut être utilisé dans certains produits spéciaux. Une partie est flexible, tandis que l'autre partie rigide, elle peut aider à économiser l'espace intérieur du produit, à réduire le volume de produit et à améliorer les performances.

13. Comment faire le calcul de l'impédance?

Le système de contrôle d'impédance est effectué à l'aide de quelques coupons de test, de l'équipement SI6000 Soft et de CITS 500S des instruments polaires.

L'équipement mesure l'impédance sur un coupon de configuration de la piste représentative dont le client nous a donné une valeur déterminée et une tolérance.